

证券代码：300567

证券简称：精测电子

公告编号：2024-151

## 武汉精测电子集团股份有限公司

### 关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、担保情况概述

武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月21日、2024年5月14日召开第四届董事会第三十五次会议、2023年度股东大会，审议通过《关于为子公司向银行申请授信提供担保的议案》，为保证公司及下属各子公司的正常生产经营，拓宽资金渠道，公司或子公司拟对子公司2024年度向银行申请综合授信提供保证担保，担保总额不超过38.5亿元人民币；其中，公司拟对子公司常州精测新能源技术有限公司（以下简称“常州精测”）向银行申请授信提供最高担保额度人民币3.9亿元，拟对上海精积微半导体技术有限公司（以下简称“上海精积微”）向银行申请授信提供最高担保额度人民币1.3亿元，授信品种：流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证、票据贴现、票据池、商业保理以及其他方式，最终以各家银行实际审批的授信额度及授信期限为准。具体内容详见公司于2024年4月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于为子公司向银行申请授信提供担保的公告》（公告编号：2024-059）。

公司分别于2024年8月16日、2024年9月2日召开第四届董事会第三十七次会议、2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，为保证公司子公司苏州精材半导体科技有限公司（以下简称“苏州精材”）的正常生产经营，拓宽资金渠道，拟对苏州精材向银行申

请授信提供最高担保额度人民币 3,000 万元，授信品种：流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证、票据贴现、票据池、商业保理以及其他方式，最终以各家银行实际审批的授信额度及授信期限为准。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 17 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于为子公司向银行申请授信提供担保的公告》（公告编号：2024-126）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关法律法规的最新规定，具体担保进展情况披露如下：

## 二、担保进展情况

为满足子公司常州精测日常经营发展需要，公司近日与中国民生银行股份有限公司武汉分行（以下简称“民生银行”）签订编号为“公高保字第 ZHHT24000011200001 号”的《最高额保证合同》，约定公司为常州精测向民生银行于保证额度有效期内发生的一系列授信业务合同提供连带责任保证担保。

为满足子公司上海精积微日常经营发展需要，公司近日与上海银行股份有限公司市南分行（以下简称“上海银行”）签订编号为“DB232240526”的《借款保证合同》，约定公司为上海精积微向上海银行于保证额度有效期内发生的一系列授信业务合同提供连带责任保证担保。

为满足子公司苏州精材日常经营发展需要，公司近日与中信银行股份有限公司苏州分行（以下简称“中信银行”）签订编号为“2024 苏银最保字第 WZ001702496341 号”的《最高额保证合同》，约定公司为苏州精材向中信银行于保证额度有效期内发生的一系列授信业务合同提供连带责任保证担保。

上述担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为上述子公司提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

## 三、担保合同的主要内容

### （一）《最高额保证合同》（编号：公高保字第 ZHHT24000011200001 号）

- 1、债权人：中国民生银行股份有限公司武汉分行
- 2、保证人：武汉精测电子集团股份有限公司

3、债务人：常州精测新能源技术有限公司

4、保证额度有效期自 2024 年 9 月 12 日起至 2025 年 9 月 12 日止

5、最高担保债权限额：最高债权本金额(人民币 150,000,000.00，大写壹亿伍仟万元整)及主债权的利息及其他应付款项之和。

6、保证方式：连带责任保证

7、保证范围：本合同约定的主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用(包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用，统称“实现债权和担保权益的费用”)。上述范围中除主债权本金/垫款/付款外的所有款项和费用，统称为“主债权的利息及其他应付款项”，不计入本合同项下被担保的主债权本金最高限额。上述范围中的最高债权本金、主债权的利息及其他应付款项均计入甲方承担担保责任的范围。

8、保证期间：该笔具体业务项下的债务履行期限届满日起三年。

#### (二) 《借款合同》(编号：DB232240526)

1、债权人：上海银行股份有限公司市南分行

2、保证人：武汉精测电子集团股份有限公司

3、债务人：上海精积微半导体技术有限公司

4、保证额度有效期自 2024 年 10 月 10 日起至 2025 年 9 月 11 日止

5、保证最高本金限额为人民币：伍仟万元整

6、保证方式：连带责任保证

7、保证范围：主合同项下所享有的全部债权，包括借款本金、利息、罚息、违约金、赔偿金、主合同项下应缴未缴的保证金及实现债权或担保物权的费用。

8、保证期间：保证人承担的保证责任期间为自本合同所述借款人履行债务的期限届满之日起 3 年。若合同项下债务人可分期履行还款义务的，保证人承担保证责任的期间为最后一笔债务履行期限届满之日起 3 年。因借款人违约，贷款人提前收回贷款时，保证期间相应提前。

#### (三) 《最高额保证合同》(编号：2024 苏银最保字第 WZ001702496341 号)

1、债权人：中信银行股份有限公司苏州分行

2、保证人：武汉精测电子集团股份有限公司

3、债务人：苏州精材半导体科技有限公司

4、保证额度有效期自 2024 年 9 月 3 日起至 2025 年 9 月 3 日

5、保证最高本金限额为人民币：伍佰万元整

6、保证方式：连带责任保证

7、保证范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

8、保证期间：本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

#### **四、累计对外担保总额及逾期担保事项**

截至本公告日，公司的所有对外担保仅限于纳入公司合并财务报表范围内的公司，担保方式为连带保证责任担保；公司及子公司尚处有效期内的实际对外担保总额为 89,370.29 万元（不含子公司对公司的担保），占公司截至 2023 年 12 月 31 日净资产的 24.12%。公司及子公司无逾期对外担保事项，无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。

#### **五、备查文件**

1、《最高额保证合同》；

2、《借款保证合同》。

特此公告。

武汉精测电子集团股份有限公司

董事会

2024年10月16日